

ISSUE

日 후지쓰—美 TI社 간 반도체 특허 분쟁의 의미

尹文涉

(기술 평가 연구실)

지난 7월 19일, 일본 4대 반도체 업체의 하나인 후지쓰는 자사의 반도체 제조 방법이 텍사스 인스투르먼트(TI)社의 특허에 저촉되지 않으므로 특허료를 지불할 의무가 없다는 확인을 구하는 소송을 동경 지방 재판소에 제기했다. 같은 날 TI도 동 재판소에 후지쓰를 특허 침해로 제소함으로써 미국과 일본을 대표하는 첨단 기술 기업들이 본격적인 특허 전쟁에 돌입할 것으로 보인다.

문제가 된 특허는 하나의 기판에 여러 가지 회로를 형성하는 집적 회로의 기본 특허로, 2001년까지 유효한 것이다. TI는 이미 이 특허로 일본 전기, 도시바, 한국의 삼성 등 상당수의 주요 기업과 크로스 라이센스 계약을 체결한 바 있다.

TI社의 젠킨스 회장은 특허료 수입을 늘이는 것이 자사의 경쟁력을 높이는 가장 중요한 수단이라고 강조하여 왔다. 실제로 TI社는 수년간 일본과 한국 기업은 물론 미국 내의 타 기업에 대해 줄곧 특허 공세를 취해 왔다. TI社는 작년 말 일본 기업들과 특허 계약이 갱신되는 시점에서부터 연간 약 2,000억 엔의 특허료를 요구하고 있다. TI社는 1M 및 4M DRAM에서 일본 기업에 뒤떨어져 있지만 풍부한 특허 자산에 의한 수입으로 설비 투자와 연구 개발을 대폭 강화하여 차세대 메모리인 16M DRAM에서는 일본 기업을 압도하려는 전략을 세워 왔다.

반면 후지쓰는 반도체 생산액이 약 4,000억 엔 규모로 일본 4위이지만 메모리 분야에서 점차 상위 3사(일본 전기, 도시바, 히다치)와 격차가 벌어지고 있으며, 메모리 생산 분야에 있어서 막대한 설비 투자 및 연구 개발비에

재투자를 하지 않으면 살아 남기 힘든 상황을 맞이하고 있다.

후지쓰의 특허 자산은 히다치나 일본 전기에 비해 약한 것으로 평가되고 있다. 뿐만 아니라 TI의 대응 여하에 따라 모든 IC의 생산 판매가 중지될 위험도 있다. 그럼에도 불구하고 TI와의 특허 분쟁을 법정으로까지 끌고 간 것은 정면 대결보다는 조금이라도 특허료 비율을 낮게 교섭하기 위한 것이 아닌가 하는 관측이다.

이번 분쟁에 대해 양국 정부는 미·일 반도체 협정이 체결된 이후라 비교적 냉정한 태도를 취하고 있다. 통산 대표부는 TI로부터 직접 들은 바가 없다며 기본적으로 기업간의 문제로 정부 차원에서 개입하지 않을 것으로 밝히고 있다. 통산성도 재판의 추이를 주시는 하겠지만 이것이 미·일 정부간의 협의 문제로는 되지 않을 것이며, 새로운 첨단 기술 마찰로 발전할 가능성은 적다고 발표하였다. 그러나 이 분쟁의 시작은 아직 TI와 계약을 체결하지 않은 다른 반도체 기업과의 교섭에 커다란 영향을 줄 것으로 예상되며, 미·일 간의 반도체 마찰의 새로운 불씨로 번질 가능성도 있다.

후지쓰와 같은 유수의 기업도 반도체 분야에서 살아 남기 위해서는 '1엔의 기술료 지불도 아깝다.'는 필사적인 자세를 취하고 있음을 보아 이 소송 사건은 반도체 분야에서 기술 경쟁이 얼마나 치열한가를 생생하게 보여 주는 한 사례이다. 이로 미루어 보아 우리나라 반도체 산업이 당면하고 있는 과도한 특허료 지불 부담도 향후 더욱 문제가 될 것으로 전망된다. *